



Fully Automatic Polisher

DFP8141

专用于蓝宝石和SiC等硬脆材料加工的CMP*抛光机

全自动规格

以Cassette to Cassette方式完成CMP加工的全自动规格。也备有清洗站自动执行加工后的晶圆清洗·干燥。

专用于小尺寸的难切削材料

适用于蓝宝石、SiC、LT、LN等材料的CMP制程。



对应三种工作物形态的搬运系统

可对应晶圆单独搬运，支撑基板搬运以及框架搬运。

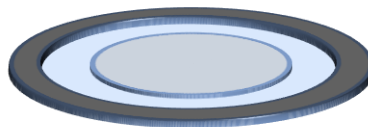
<各搬运系统的工作物状态>



晶圆单独搬运
(根据晶圆厚度贴附胶膜)



支撑基板搬运



框架搬运

规格

Specification	Unit	DFP8141	
Wafer diameter	-	ø8"	
Polishing method	-	CMP	
Polishing wheel	mm	ø300 mm pad	
Spindle	Rated output	kW	7.5
	Revolution speed	min-1	500 – 2,000
Machine dimensions (W x D x H)	mm	900 x 2,584 x 2,000	
Machine weight	kg	3,100	

■使用条件

- 请使用大气压露点在-10 ~ -20 °C之间，残余油分为0.1 ppm，过滤度为0.01 μm/99.5%以上的清洁压缩空气。
- 请将机械设备所在空间的室温设定在20 °C ~ 25 °C之间，并将波动范围控制在±1以内。
- 请将切削水的水温控制为室温 + 2 °C（波动范围在±1 °C以内），并将冷却水的水温控制为与室温相同（波动幅度在±1 °C以内）。
- 此外，请避免设备受到撞击以及有感振动等的外部振动。并请不要将设备设置于风扇，通风口以及易于产生高热或油污等的装置附近。
- 本设备将使用水。为了防范漏水造成的影响，请将设备设置于备有防水地板以及排水处理的场所。

※ 基于设备改善，本公司可能在不通知用户的情况下变更本规格。因此，请详加确认后再发出订单。

※ 压力皆以压力表指示压力值表示。

※ 关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司销售部门联络。